

Title (en)

Method for structural bonding on painted surfaces

Title (de)

Verfahren für strukturelles Kleben auf Lackoberflächen

Title (fr)

Procédé de collage structurel sur des surfaces peintes

Publication

**EP 1239017 A1 20020911 (DE)**

Application

**EP 01104544 A 20010305**

Priority

EP 01104544 A 20010305

Abstract (en)

A surface is coated with a structural polymer in a bonding region. The surface is provided is a lacquer layer. The lacquer layer is removed from the structural polymer prior to the application of an assembly adhesive.

Abstract (de)

Es wird ein neues Verfahren für das Kleben von lackierten Bauteilen, insbesondere für das strukturelle Kleben von lackierten Metalloberflächen beschrieben. Beim erfindungsgemässen Verfahren wird in einem ersten Schritt ein Rohbauklebstoff überall dort auf das beölte Stahlblech appliziert, wo nachher in der Montage verklebt wird. Für das Kleben werden die Lackschichten auf dem Rohbauklebstoff vor dem Aufbringen eines Montageklebers entfernt. Dieses Verfahren ist einfach und robust, ist wirtschaftlicher im Vergleich zum Stand der Technik, ermöglicht ein hochstrukturelles oder hochfestes Verbinden mit hoher Torsionssteifigkeit und eine hohe alterungsbeständige Verbundqualität.

IPC 1-7

**C09J 5/06**

IPC 8 full level

**B05D 7/24** (2006.01); **B05D 1/32** (2006.01); **B05D 3/12** (2006.01); **B60J 10/70** (2016.01); **C03C 27/04** (2006.01); **C09J 5/06** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B60J 10/70** (2016.02 - EP US); **C03C 27/048** (2013.01 - EP US); **C09J 5/06** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

[A] WO 9404470 A1 19940303 - ESSEX SPECIALTY PROD [US]

Cited by

EP2926951A1; EP3587084B1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1239017 A1 20020911**; **EP 1239017 B1 20040128**; AT E258578 T1 20040215; CA 2365975 A1 20020905; DE 50101394 D1 20040304; ES 2215096 T3 20041001; JP 2002282783 A 20021002; PT 1239017 E 20040630; TR 200400871 T4 20040621; US 2002121332 A1 20020905; US 6797099 B2 20040928

DOCDB simple family (application)

**EP 01104544 A 20010305**; AT 01104544 T 20010305; CA 2365975 A 20011220; DE 50101394 T 20010305; ES 01104544 T 20010305; JP 2002049408 A 20020226; PT 01104544 T 20010305; TR 200400871 T 20010305; US 5369602 A 20020124